



Conselho da
União Europeia

**Bruxelas, 21 de novembro de 2018
(OR. en)**

**14559/18
ADD 1**

**ENV 797
MI 870
DELECT 153**

NOTA DE ENVIO

de:	Secretário-Geral da Comissão Europeia, assinado por Jordi AYET PUIGARNAU, Diretor
data de receção:	19 de novembro de 2018
para:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

n.º doc. Com.:	C(2018) 7499 final - Anexo
Assunto:	ANEXO da Diretiva Delegada (UE) .../... da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, o documento C(2018) 7499 final - Anexo.

Anexo: C(2018) 7499 final - Anexo



Bruxelas, 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

ANEXO

da

Diretiva Delegada (UE) .../... da Comissão

que altera, para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip

ANEXO

No anexo III, a entrada 15 passa a ter a seguinte redação:

«15	Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo <i>Flip Chip</i>	Aplica-se às categorias 8, 9 e 11 e caduca em: <ul style="list-style-type: none">– 21 de julho de 2021, para as categorias 8 e 9, com exceção dos dispositivos médicos de diagnóstico <i>in vitro</i> e dos instrumentos industriais de monitorização e controlo;– 21 de julho de 2023, para os dispositivos médicos de diagnóstico <i>in vitro</i> da categoria 8;– 21 de julho de 2024, para os instrumentos industriais de monitorização e controlo da categoria 9 e para a categoria 11.
15 a)	Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo <i>Flip Chip</i> , desde que seja cumprido um dos seguintes critérios: <ul style="list-style-type: none">– nó tecnológico de semicondutor de 90 nm ou dimensão superior;– pastilha única de 300 mm² ou área superior em qualquer nó tecnológico de semicondutor;– invólucros de pastilhas empilhadas com pastilhas de 300 mm² ou área superior, ou interpositores de silício de 300 mm² ou área superior.	Aplica-se às categorias 1 a 7 e 10 e caduca em 21 de julho de 2021.»